

國立雲林科技大學學生申請智慧系統設計與製造學程規定

106年6月6日第95次教務會議通過

- 一、本校學生申請修習智慧系統設計與製造學程，悉依本規定辦理。
- 二、本校為配合國家發展智慧系統產業所需之跨領域系統設計與製造整合人才，推動智慧系統設計與製造學程人才培育計畫，開設智慧系統設計與製造學程（以下簡稱本學程），培育跨領域之系統層級並具產業實務能力之人才。供本校各年級之大學部學生在校期間修習。
- 三、本學程大學部學生應修學分數至少十五學分。
- 四、修習本學程之學生未在規定修業期限內修滿應修學分者，得申請延長修業年限一至二年。
- 五、本學程之各課程，若遇開課單位變更科目名稱，以致與本學程課程表列名稱不符，則以開課單位變更後之科目名稱為主。
- 六、修畢本學程之學生，經成績考核及格，由本校發給智慧系統設計與製造學程證明書。
- 七、本規定未盡事宜，悉依本校學則及相關法令之規定辦理之。
- 八、本規定經本校教務會議通過，陳請校長核定後施行，修訂時亦同。

國立雲林科技大學學生選讀智慧系統設計與製造學程課程注意事項

106年5月25日第52次校課程委員會會議通過

- 一、 本學程學生修習本學程科目，延長修業年限者，其修習學分不受此限。
- 二、 本學程需修習【核心必修應用專題】一門課程，及【必修相關實務課程】實務專題(一)或產業實務實習(一)與實務專題(二)或產業實務實習(二)，且課程需與智慧系統設計與製造相關。
- 三、 本學程應修學分數至少十五學分，修習本學程之學生須跨修其他學院至少一門課程，本學程修課課程規定如下：
 - i. 核心必修應用專題 (3 學分)
智慧科技應用專題 (電子與創設系合開)
 - ii. 必修相關實務課程 (6 學分，課程內容需與智慧系統相關)
 1. 實務專題(一)或產業實務實習(一) (最高承認 3 學分)
 2. 實務專題(二)或產業實務實習(二) (最高承認 3 學分)
 - iii. 核心選修課程：(至少跨修其他學院一門課程)
 1. 智慧系統設計領域：控制系統(3 學分，電機)、系統雛型與軟硬體設計(3 學分，電子)、嵌入式系統導論(3 學分，電機)、數位影像處理(3 學分，電子)
 2. 智慧系統製造領域：高速印刷電路板設計與製造(3 學分，電子)、積體電路封裝技術(3 學分，電子系)
 3. 智慧生活系統應用領域：創客-概念發想(3 學分，電子創設合開)、雙向生醫電子系統(3 學分，電子)
 4. 深度學習與軟體應用領域：影像辨識技術(3 學分，資工)、APP 程式設計(3 學分，資工)、iOS 智慧裝置軟體設計(3 學分，資工)
 5. 智慧生產與管理領域：專業倫理與智慧產權(3 學分，資工)、專業倫理與智慧產權(3 學分，電機)、生產管理(3 學分，工管)、品質管理(3 學分，工管)
- 四、 本注意事項經校課程委員會通過後實施並適用於學程全體學生。

智慧系統設計與製造學程課程流程圖

大二		大三		大四		碩一	
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期
■ 核心必修應用專題(共 3 學分)							
				智慧科技應用專題 (電子創設合開, 3 學分)			
■ 必修相關實務課程(共 6 學分)							
		實務專題(一) (最高承認 3 學分)		實務專題(二) (最高承認 3 學分)			
		產業實務實習 (一)(最高承認 3 學分)		產業實務實習 (二)(最高承認 3 學分)			
■ 核心選修：智慧系統設計領域							
		自動控制 (電機, 3 學分)		嵌入式系統導論 (電機, 3 學分)		系統雛型與軟硬體設計 (電子, 3 學分)	
						數位影像處理 (電子, 3 學分)	
■ 核心選修：智慧系統製造領域							
						高速印刷電路板設計與製造 (電子, 3 學分)	
						積體電路封裝技術 (電子, 3 學分)	
■ 核心選修：智慧生活系統應用領域							
		創客：概念發想 (電子創設合開, 3 學分)		雙向生醫電子系統 (電子, 3 學分)			
■ 核心選修：深度學習與軟體應用							
		APP 程式設計 (資工, 3 學分)		影像辨識技術 (資工, 3 學分)			
		iOS 智慧裝置軟體設計 (資工, 3 學分)					
■ 核心選修：智慧生產與管理領域							
		生產管理 (工管, 3 學分)		專業倫理與智慧產權 (電機 3 學分)			
		品質管理 (工管, 3 學分)		專業倫理與智慧產權 (資工 3 學分)			